

Sputtern an Atmosphärendruck



1. Motivation Metallisierungen mit Schichtdicken im nm- bis mm-Bereich finden vielfältige industrielle Anwendungen. Derzeit werden solche Schichten entweder chemisch oder galvanisch abgeschieden oder unter Vakuum hergestellt. Im Vakuum finden dabei vorzugsweise PVD-Verfahren (Aufdampfen, Sputtern) Anwendung. Die chemische Abscheidung und galvanische Verfahren haben technische Einschränkungen bezüglich Schichtkontrollierbarkeit und Substratmaterialien, Vakuumverfahren benötigen eine aufwändige Anlagentechnik und sind nicht sehr flexibel einsetzbar. Hier wird ein neues Verfahren vorgestellt, mit dem es möglich ist, Beschichtungen durch Sputtern bei Atmosphärendruck durchzuführen. Dies eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten und verspricht Kosteneinsparungen bei existierenden Anwendungen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)